深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

证券简称: 联得装备

证券代码: 300545

编号: 2025-004

投资者关系活动类别	□特定对象调研	□分析师会议	
	□媒体采访	□业绩说明会	
	□新闻发布会	□路演活动	
	□现场参观	其他 电话会议	
参与单位名称及人员	一、3月3日		
姓名	第一场: 电话会议 中信资管、天风证券共 4 人		
	二、3月4日		
	第一场: 电话会议 国投瑞银基金、广发证券共 3 人		
	第二场: 电话会议		
	太平洋资产管理、广发证券共3人		
时间	2025年3月3日-3月4日		
地点	电话会议		
上市公司接待人员	董事、副总经理: 胡金先生		
姓名	董事、董事会秘书: 刘雨晴女士		
	一、介绍公司概况		
	简要介绍公司及子	公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩,公	
投资者关系活动主要	司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。		
内容介绍	二、投资者会议问答交流		
	Q1: 公司主要竞争优势是什么?		
	A1: 公司深耕半导	体显示设备行业二十余年,经历了显示产业的多种	
	技术变革,通过多年的	技术沉淀和积累实现了半导体显示产业各种技术之	
	间的掌握和融合,具备	了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平,使公	

司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。公司凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势,以及全方位的、高质量的售前、售中、售后个性化、定制化服务,公司在业内树立了良好的口碑,公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户,与包括大陆汽车电子、博世、伟世通、京东方、维信诺、深天马、德赛西威、华星光电、苹果、富士康、夏普、业成、蓝思科技、惠科等知名企业建立了良好的紧密的合作关系。公司凭借行业经验优势、研发创新优势、品牌优势、综合服务优势、客户资源优势,实现了公司经营规模及业绩的稳定增长。

O2: 公司在三折屏供应链中有出货哪些设备?

A2: 公司在三折屏供应链中,提供了贴合类工艺设备的整体解决方案,已形成销售订单并出货。公司作为折叠屏贴合类设备相关细分市场的领先企业,持续发挥技术领先优势,为"中国智造"贡献力量。

Q3: 公司在 VR/AR/MR 显示领域有何布局?

A3:公司通过不断推陈出新打破技术壁垒,持续自主研发创新,研发的设备已经赢得了 VR/AR/MR 等新型显示领域客户的青睐。在 VR/AR/MR显示设备领域,公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备,相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系。

O4: 公司在半导体领域生产销售哪些设备?

A4:公司在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备。主要产品是 COF 倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、AOI 检测机、引线框架贴膜机等高速高精的半导体装备。目前共晶、软焊料等固晶机和 QFN 引线框架贴膜、引线框架检测等设备已经交付客户量产。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势,积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。

O5: 公司在 Mini/Micro LED 显示领域进展情况如何?

A5: 公司目前在 Mini/Micro LED 显示领域,已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。

O6: 公司在海外市场有哪些客户?

	A6: 在海外市场,公司积累了如大陆汽车电子、博世、伟世通等诸多	
	世界 500 强的客户资源,并建立了良好的合作关系。公司在该行业的布局	
	逐渐在订单中变现,特别是公司与国外大客户的深度合作,实现了设备在	
	欧洲、东南亚、北美的落地。	
附件清单(如有)	无	
日期	2025-3-4	